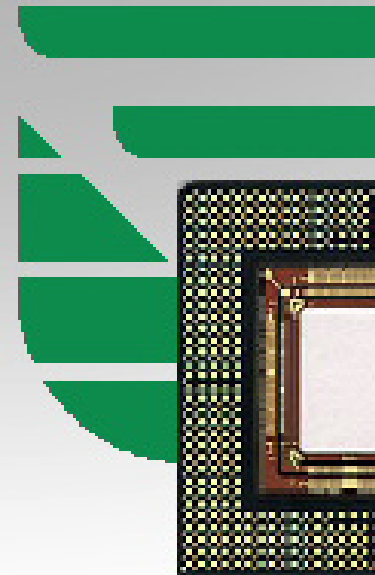


# 85. Treffen



SACHSEN



**VDE / VDI**

*Sächsischer  
Arbeitskreis  
Elektronik-  
Technologie*

*am 3. Dezember 2025*

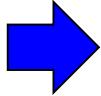
bei der Turck Beierfeld GmbH in Grünhain – Beierfeld

**Mit Expertise von der Idee zum Produkt**

# 85. Treffen

## Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreis Elektronik-Technologie

Reinhard Bauer; Martin Oppermann



- **Neues aus dem IAVT der TU Dresden**
- **Anmerkungen zum 85. Treffen**
- **Vorschau zu den nächsten Treffen**
- **Weitere ausgewählte Informationen / Diskussion**
- **Abschließende Anmerkungen**

- **Neuigkeiten aus dem IAVT der TU Dresden**

News des IAVT der TUD am 21.10.2025

### **Martin Oppermann zum Professor bestellt**



„PD Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann wurde mit Wirkung vom 14.10.2025 zum apl. Professor für das Lehrgebiet „Zerstörungsfreie Prüfung elektronischer Baugruppen“ bestellt. Damit werden sein nun bereits fast 30jähriges Wirken am IAVT/ZmP der TU Dresden sowie sein Engagement in Lehre und Forschung gewürdigt.“

**Der Sächsische Arbeitskreis Elektronik-Technologie gratuliert ihm ganz herzlich dazu und wir freuen uns auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit !**

- Prof. Martin Oppermann studierte von 1985 bis 1990 an der Technischen Hochschule Ilmenau an der Sektion Gerätetechnik und diplomierte auf dem Gebiet der Informationsgerätetechnik.
- Seit 1997 ist er an der TU Dresden am IAVT, promovierte 2002 zur „Modellierung und Optimierung des Qualitätsverhaltens von Fertigungsprozessen in der Elektronik“
- 2014 nach erfolgreicher Habilitation erhielt er den Lehrauftrag zur „Zerstörungsfreien Prüfung“ als Privatdozent
- Seit 2007 ist er Koordinator des "Kompetenzzentrums für hochauflösende zerstörungsfreie Prüfverfahren - nanoeva®„
- Er ist stellvertretender Direktor des Zentrums für Mikrotechnische Produktion an der TU Dresden

## Aktuelle Informationen und Anmerkungen beim 85. Treffen

- **Neuigkeiten aus dem IAVT der TU Dresden**

### Das IAVT an der TU Dresden hat eine neue Leitung



News des IAVT der TUD am 01.11.2025

**Mit Wirkung vom 1.11.2025 ist Frau Prof. Dr.-Ing. Juliana Panchenko die neue Direktorin des IAVT.**

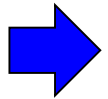
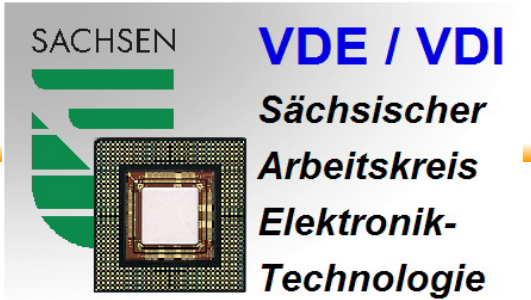
**Der Sächsische Arbeitskreis Elektronik-Technologie gratuliert ihr ganz herzlich dazu!**

- Frau Prof. Panchenko studierte Mikroelektronik an der Nationalen Technischen Universität der Ukraine in Kyiv (bis 2009). Ihre Masterarbeit (Mikrostrukturuntersuchungen an bleifreien Lotwerkstoffen) führte sie im Rahmen eines Forschungsaufenthalts 2009 am IAVT der TU Dresden durch.
- Anschließend war sie am IAVT als wiss. Mitarbeiterin und Doktorandin tätig und erlangte ihre Promotion 2013. ....
- Seit Juli 2014 war sie als Juniorprofessorin für „Nanomaterials for Electronics Packaging“ am IAVT tätig und arbeitete gleichzeitig als Gruppenleiterin auf dem Gebiet der 3D-Systemintegration und des Wafer-Level-Packaging am Fraunhofer IZM-ASSID. Ab März 2024 war Frau Prof. Panchenko Honorar-Professorin.“
- Prof. Bock als bisheriger Direktor und nun Seniorprofessor übergab symbolisch den Staffelstab an sie.

# 85. Treffen

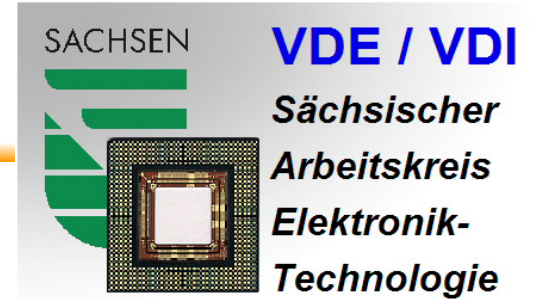
## Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreis Elektronik-Technologie

Reinhard Bauer; Martin Oppermann



- **Neues aus dem IAVT der TU Dresden**
- **Anmerkungen zum 85. Treffen**
- **Vorschau zu den nächsten Treffen**
- **Weitere ausgewählte Informationen / Diskussion**
- **Abschließende Anmerkungen**

## Aktuelle Informationen und Anmerkungen beim 85. Treffen



- **Anmerkungen zum 85. Treffen - Rückschau**

### 80. Treffen

**29.03.2023** Fraunhofer IKTS in Dresden  
Innovative keramische Techniken

### 81. Treffen

**08.11.2023** dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH in Dresden  
Von der Entwicklung bis zur Entsorgung - Neues aus der Elektronikbranche

### 82. Treffen

**13.03.2024** WAGO GmbH & Co. KG in Sondershausen  
Industrie 4.0 in der Anwendung bei der Produktion elektrotechnischer Produkte

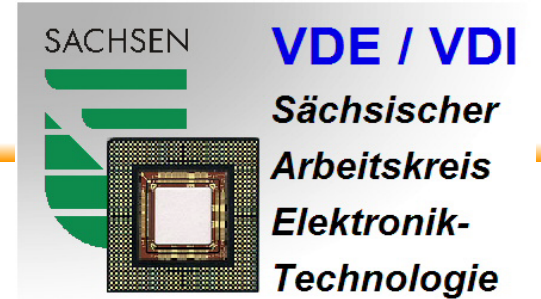
### 83. Treffen

**11.12.2024** KYOCERA AVX Components (Dresden) GmbH in Klingenberg  
Sensoren für Automotive und Industrie

### 84. Treffen

**30.04.2025** Frolyt Kondensatoren und Bauelemente GmbH in Freiberg  
Kondensatoren und spezielle Lösungen für Sondermaschinen und Anlagentechnik

## Aktuelle Informationen und Anmerkungen beim 85. Treffen



### • Anmerkungen zum 85. Treffen - Rückschau

#### 80. Treffen

29.03.2023 Fraunhofer IKTS in Dresden  
Innovative keramische Techniken

#### 81. Treffen

08.11.2023 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH in Dresden  
Von der Entwicklung

#### 82. Treffen

13.03.2024 WAGO GmbH & Co. KG  
Industrie 4.0 in der Produktion

#### 83. Treffen

11.12.2024 KYOCERA AVX  
Sensoren für Automobilanwendungen

**Vielen Dank an die, die den Arbeitskreis ermöglichen:**

- **Gastgeber, die mit Räumlichkeiten, Ausgestaltung und ihrem Profil eine Basis für eine fachliche und praxisnahe Diskussion bieten**
- **Referenten für die interessanten Beiträge**
- **Teilnehmer für das Interesse und die Diskussionen**

#### 84. Treffen

30.04.2025 Frolyt Kondensatoren und Bauelemente GmbH in Freiberg  
Kondensatoren und spezielle Lösungen für Sondermaschinen und Anlagentechnik

# **85. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie Mit Expertise von der Idee zum Produkt**

**Mittwoch, 3. Dezember 2025  
bei der Turck Beierfeld GmbH  
in Grünhain –Beierfeld**

## Aktuelle Informationen und Anmerkungen

- Vorschau zu den nächsten Treffen 2026

86. Treffen April 2025 (29.4.26 oder 15.4.26)

**KSG GmbH**

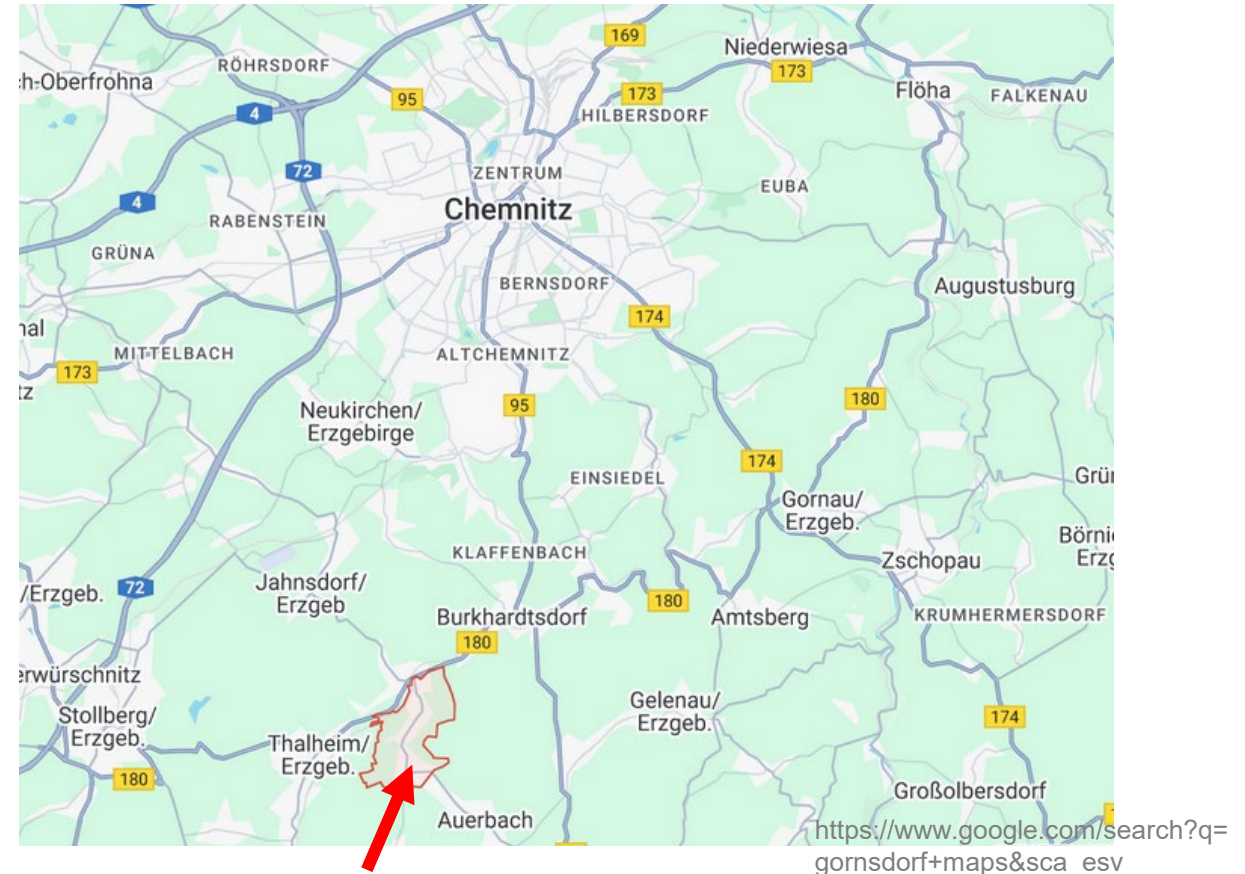
in Gornsdorf im Erzgebirge  
Auerbacher Str. 3-5

Vorläufiger Titel:

**Innovationen in der Leiterplattentechnik**



Fotos: KSG GmbH



Gornsdorf, KSG GmbH

## Aktuelle Informationen und Anmerkungen

### • Vorschau zu den nächsten Treffen 2026

86. Treffen April 2026

KSG GmbH in Gornsdorf im Erzgebirge

**Vielen Dank Herrn Fiehler für die Zusage als Gastgeber!**

Vorläufige Konzeption (alles Arbeitstitel mit Vorbehalt)

### Innovationen in der Leiterplattentechnik

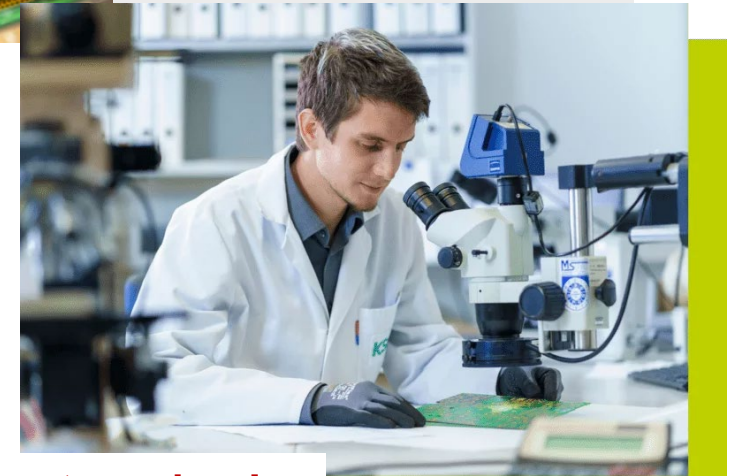
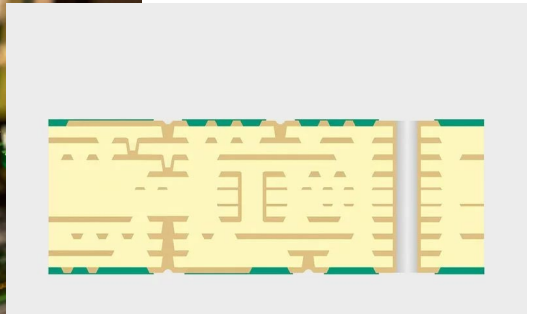
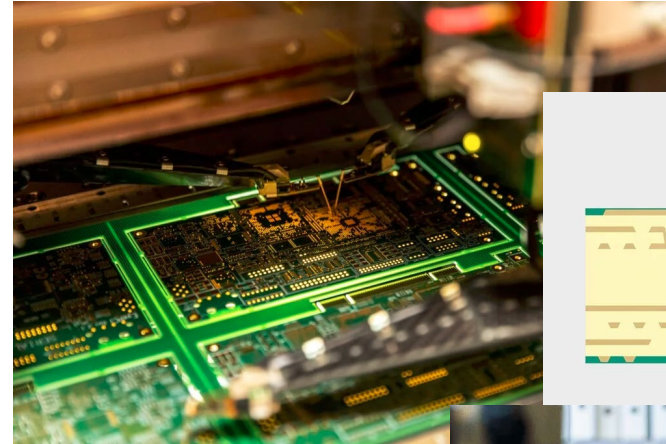
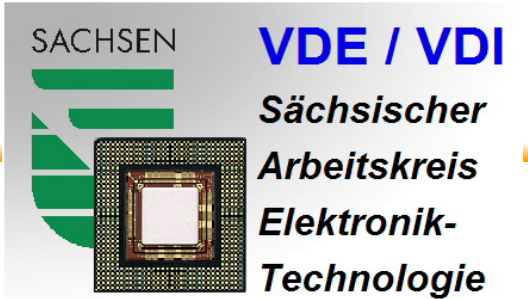
Beginn: 10:00 Uhr

mögliche Schwerpunkte (Agenda kommt noch rechtzeitig):

- *Moderne Aufbauvarianten und Leiterplattentechnologien*
- *Funktionalität und spezielle Lösungen*
- *Design und Fertigung – Design-to-Cost?*
- *Qualität und Zuverlässigkeit – Prüfung und Dokumentation*
- *Fertigungsrundgang*
- *Weitere Beiträge von KSG-Partnern und anderen*

**Weitere Informationen werden auf der Home Page bzw. in Rund-Mails noch bekanntgegeben!**

**Wir freuen uns auf ein interessantes Treffen!**



Abbildungen : KSG GmbH

# 85. Treffen

## Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Reinhard Bauer; Martin Oppermann

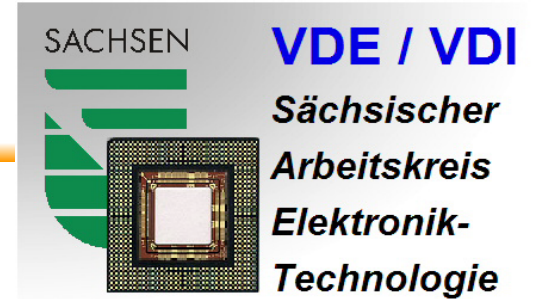
- Neues aus dem IAVT der TU Dresden
- Anmerkungen zum 85. Treffen
- Vorschau zu den nächsten Treffen

### ➔ • Weitere ausgewählte Informationen / Diskussion

- **VDI-BV: neuer Leiter der Geschäftsstelle ist Herr Lorenz Köhler, Frau Andrea Nickol ist weiterhin da erreichbar**
- **Projektinitiative BioSolder an der HTW Dresden (Prof. M.-P. Schmidt) und einigen Firmen zur Entwicklung von Materialien und Technologien für die Elektronikmontage auf nachhaltigen Substraten für Applikationen mit begrenzten Anforderungen**  
– interessierte Partner für den Anwendungsbereich sind noch willkommen

## 85. Treffen

# Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



Reinhard Bauer; Martin Oppermann

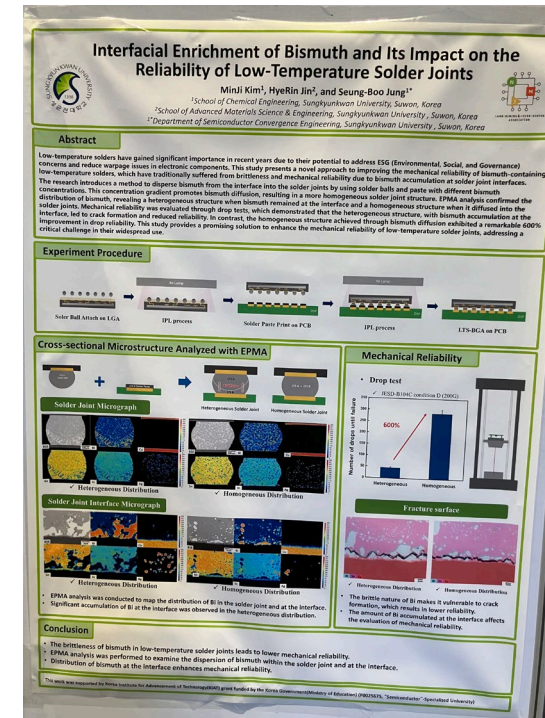
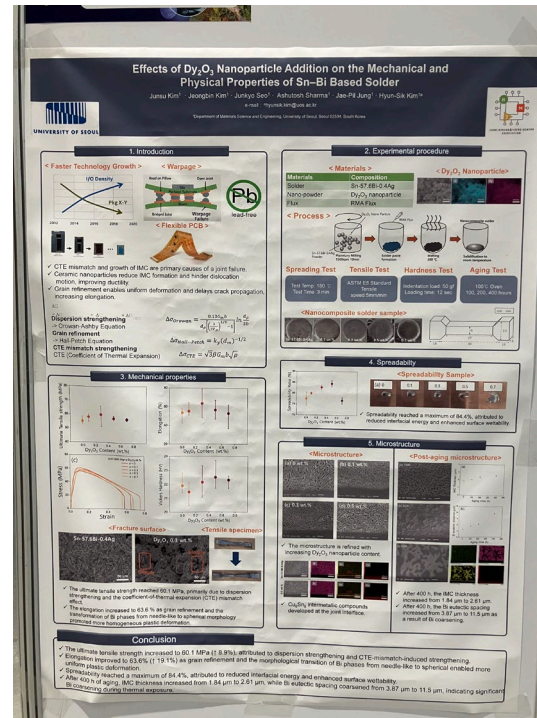
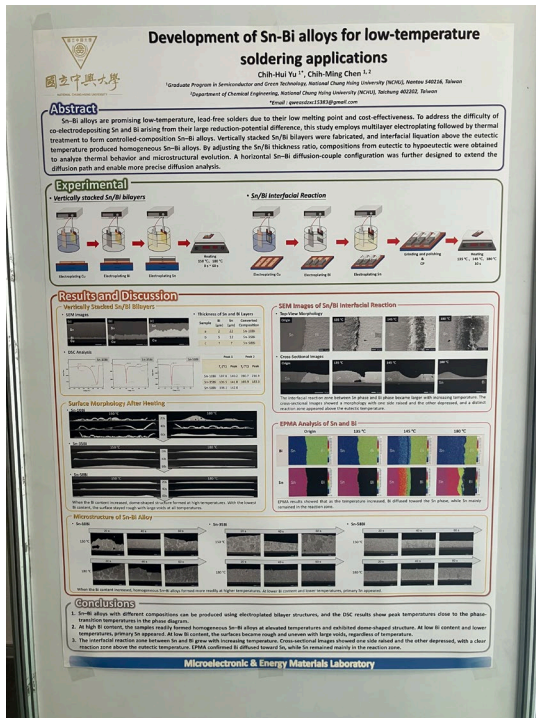
- **Weitere ausgewählte Informationen / Diskussion**
  - **Projektinitiative BioSolder an der HTW Dresden (Prof. M.-P. Schmidt) und einigen Firmen zur Entwicklung von Materialien und Technologien für die Elektronikmontage auf nachhaltigen Substraten für zeitlich begrenzt einsetzbare Anwendungssysteme (Sensoren, RFID, Logistik)**
    - **Biobasiertes und bioabbaubares Substrat**
    - **Verfahren zur Erzeugung einer leitfähigen oder metallisierbaren Schicht im Vergleich zur Laminierung einer Kupferschicht**
    - **Niedertemperaturlöten mit bleifreien Loten im Vergleich mit Klebeverbindungen bei der Oberflächenmontage**
  - **interessierte Partner für den Anwendungsbereich sind noch willkommen**  
(E-Mail an [Marc-Peter.Schmidt@htw-dresden.de](mailto:Marc-Peter.Schmidt@htw-dresden.de) oder an Prof. Bauer)

# 85. Treffen

## Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

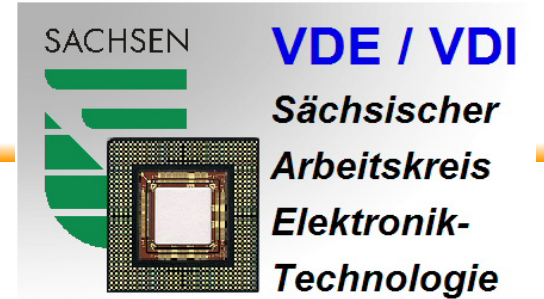
Reinhard Bauer; Martin Oppermann

- Beitrag von Herrn Prof. Türpe zu niedrigschmelzenden Sn-Bi-Loten (Quelle <https://2025.nmj.org/>):  
Poster 1 (verlinkt): Poster 34 (verlinkt): Poster 37 (verlinkt):



## 85. Treffen

# Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreis Elektronik-Technologie



Reinhard Bauer; Martin Oppermann

- **Beitrag von Herrn Prof. Türpe zur Arbeit des FA 10 „Mikroverbindungstechnik“ des DVS:**
  - **Zur Zeit wird die Anfinanzierung des folgenden Vorhabens vorbereitet:**

**Zuverlässigkeit niedrigschmelzender Weichlote auf SnBiX-Basis in der Elektronikfertigung mit ganzheitlicher Lötbarkeitsbetrachtung unter Berücksichtigung von Wirkmechanismen an den Grenzflächen**

**Fraunhofer-Gesellschaft e.V. Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM**

Forschungseinrichtungsleiter: Schneider-Ramelow, Prof. Dr.-Ing. Martin

Projektleiter: Hutter, Dr.-Ing. Matthias

**Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT)**

Forschungseinrichtungsleiter: Kapels, Prof. Holger

Projektleiter: Schimanski, Helge

1. Pate: Ahrens, Dr.-Ing. Thomas (Trainalytics GmbH)

## → Anregungen, Angebote, Meinungen, Ideen, Hinweise?

**Obmann:** Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden  
E-Mail: [reinhard.bauer@htw-dresden.de](mailto:reinhard.bauer@htw-dresden.de)

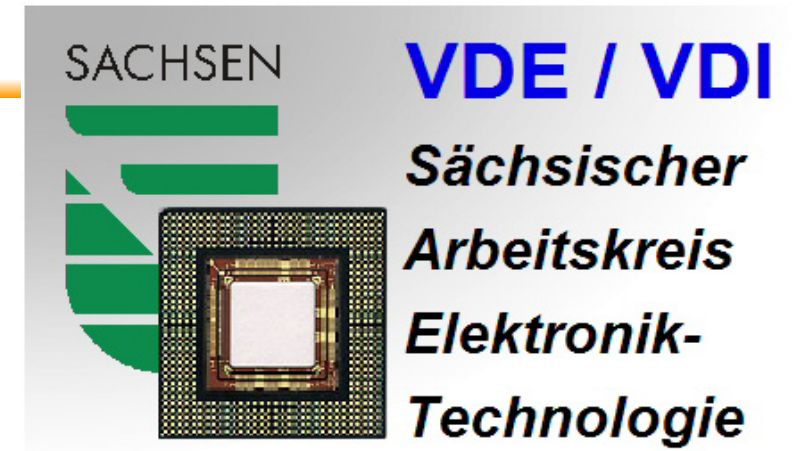
**Koordinator:** Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann,  
TU Dresden, IAVT / ZμP  
E-Mail: [martin.oppermann@tu-dresden.de](mailto:martin.oppermann@tu-dresden.de)

**<https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/>**

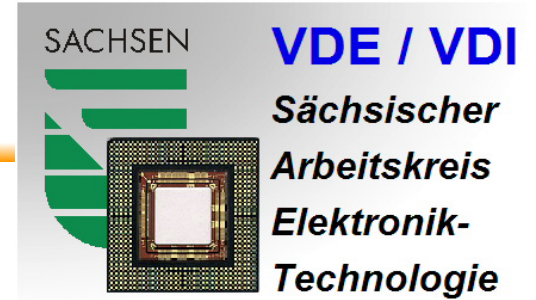
### **Hinweise:**

Bitte an die Referenten, ihren Beitrag als PDF für die Veröffentlichung auf der Home Page des Arbeitskreises (je nach Freigabe) zur Verfügung zu stellen.

Fotos während der Veranstaltungen werden teilweise zu Veröffentlichungen des Arbeitskreises genutzt.



# Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Ganz herzlichen Dank an  
die Turck Beierfeld GmbH,  
insbesondere Herrn GF Hanisch, dass die Veranstaltung heute hier möglich war und  
Herrn Seidel und seinen Kolleginnen und Kollegen,  
die alles vorbereitet und gestaltet haben.

Vielen Dank auch an alle Referenten für die interessanten Beiträge und Diskussionen  
und auch an alle, die die Fertigungsführung gestaltet haben.

Allen Teilnehmern ebenfalls ein Dankeschön für das rege Interesse!

Wir freuen uns auf die nächsten Treffen -  
Über weitere Angebote als Gastgeber und Referenten freuen wir uns immer!

## 85. Treffen

# Informationen aus und für den Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

*Es war sehr schön heute hier im Erzgebirge =  
Weihnachtsgebirge!*

*Wir wünschen allen einen schönen Advent,  
frohe Weihnachten und guten Rutsch ins 2026 –  
Gesundheit, Glück und Erfolg!*

*Merken Sie sich im neuen Kalender das Treffen im April schon  
etwas vor bzw. informieren Sie sich rechtzeitig auf der Home Page  
<https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/>*

